

TW:6531

愛普科技股份有限公司

法人說明會

2019.05.22
凱基證券12F

免責聲明

簡報中所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性。任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況，本簡報資料中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。



報告大綱

- 引言
- 財報概況
- 產品線概況
- 未來業務方向展望

引言: 高度挑戰的一年!!

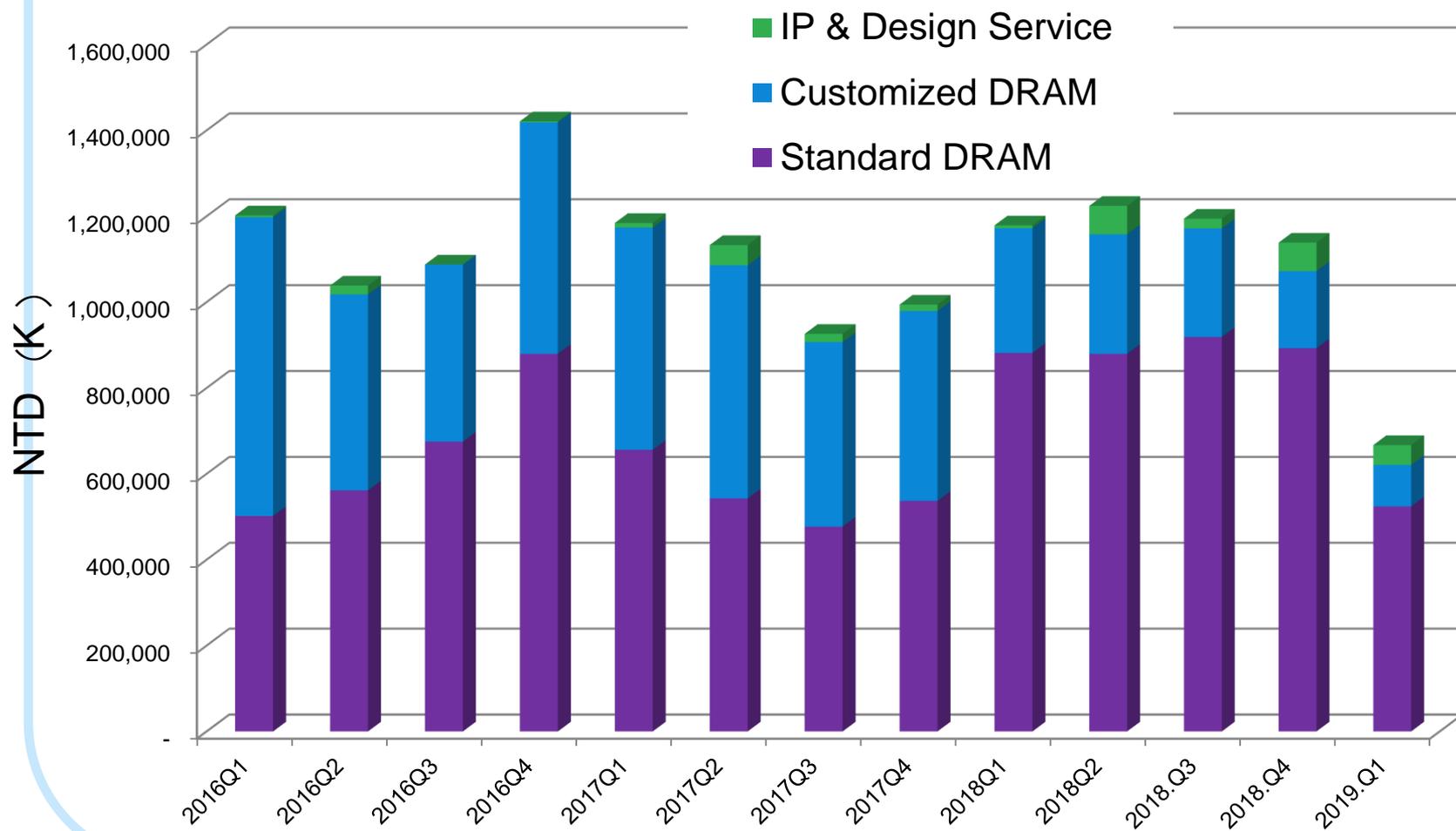
- 坦誠面對因失誤而造成重大損失，謙卑改善
- 正視產業難關，調整策略審慎應對
 - 強化內部管理
 - 明確營運策略
 - 新設執行長，強化公司管理
- 展望未來，AI/IoT/穿戴式裝置將帶來長期穩定的發展

2019.Q1 財報概況

- 2019年第一季財務報告彙整
 - 營運淨損1.25億元
 - 一次提列新台幣3.42億元之損失
 - 分三年期抵扣貨款，諒不致對資金周轉有重大影響
 - 客戶關係正常，不影響合作
 - 庫存17.4億元，超出正常水平，去化中
 - 期末現金4.13億元，預期現金隨庫存去化增加

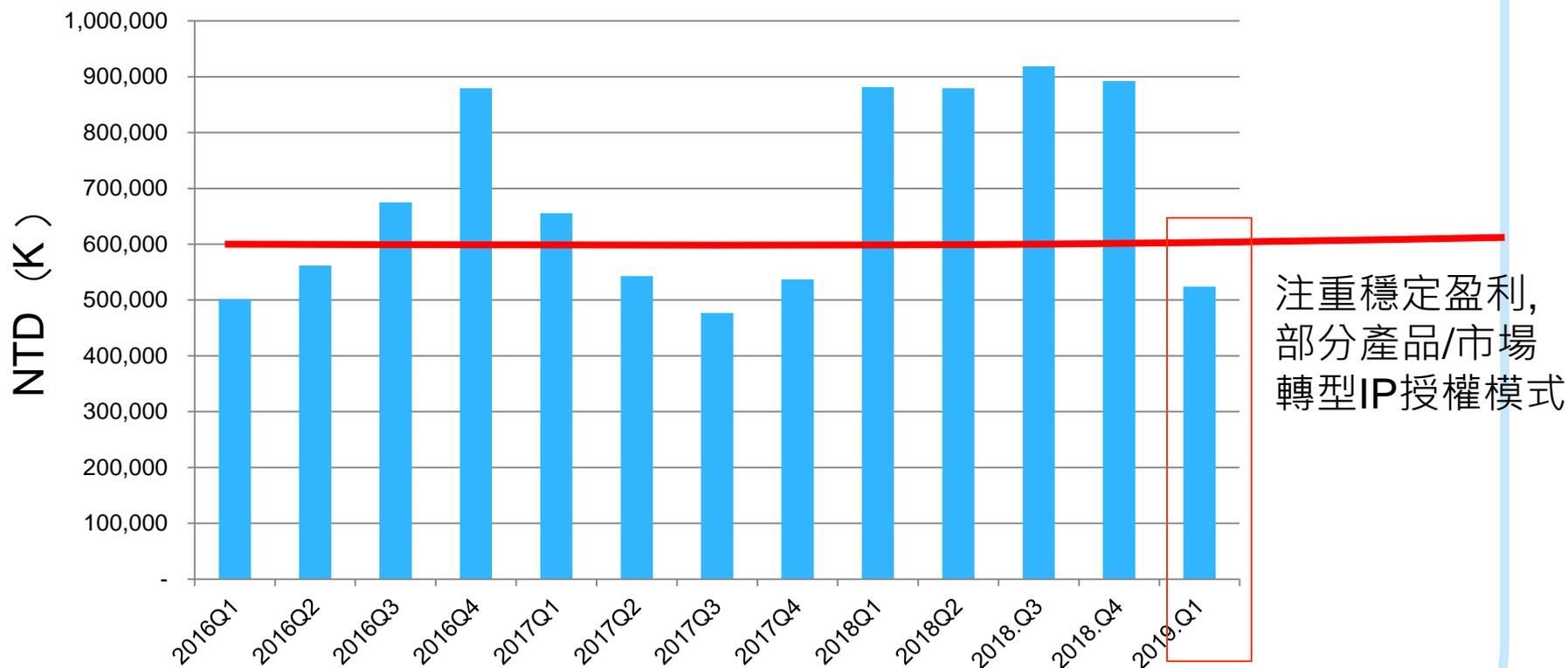
產品線概況

產品線營收分佈

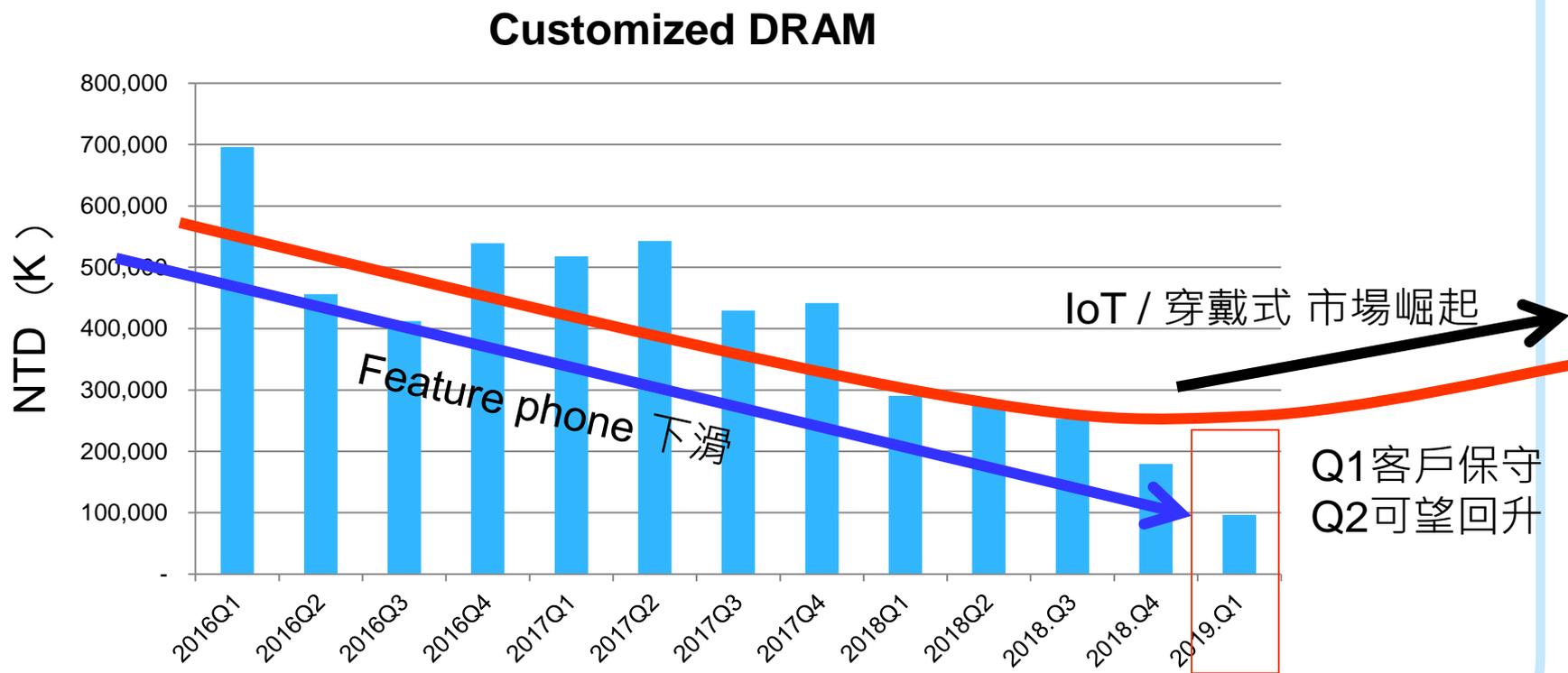


標準DRAM：部分市場長期穩定

Standard DRAM



客製化DRAM：市場可望回溫

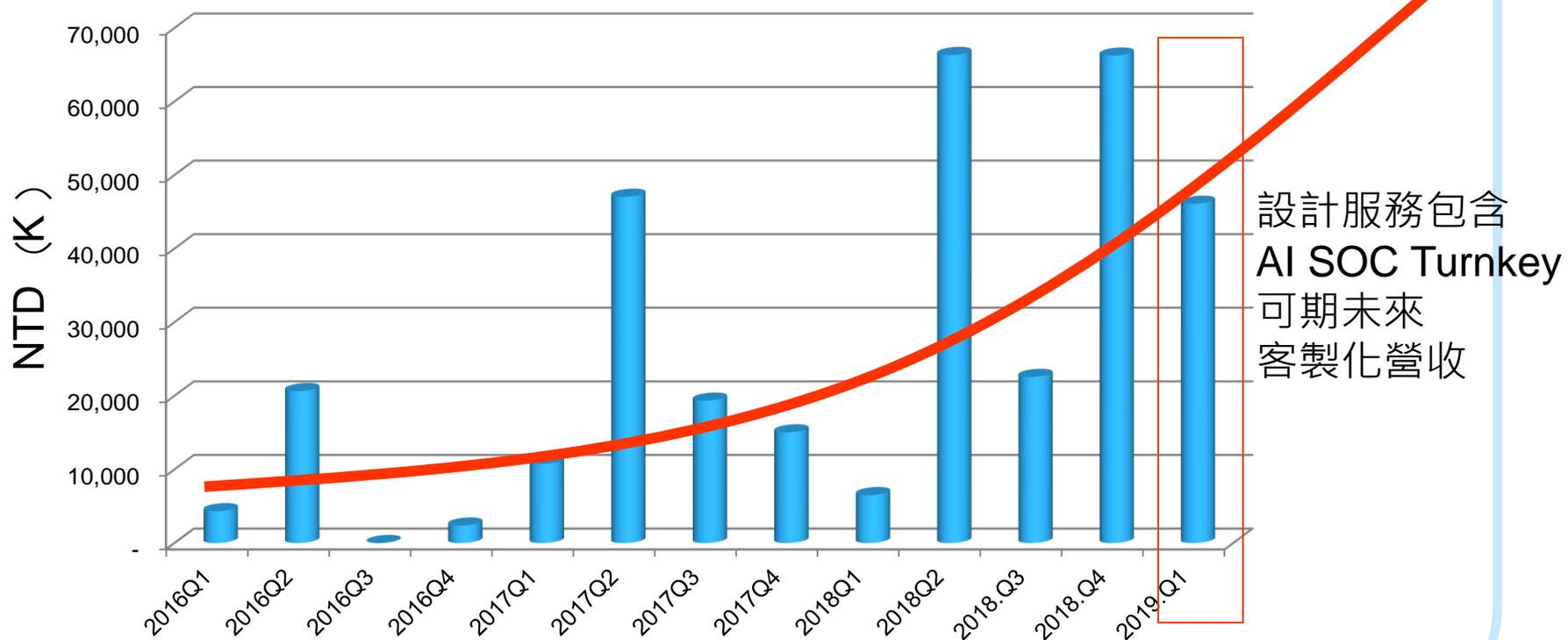


客製化應用市場- More than Feature Phone!

- Feature Phone – 持續下滑
- 物聯網 – 成長期，有望超越Feature Phone市場
- 可穿戴 – 成長期，高附加值
- 人工智能 – 初期，爭奪Spec制定權
- 其他應用市場

IP授權/設計服務: 穩步增長

IP Licensing & Design Service

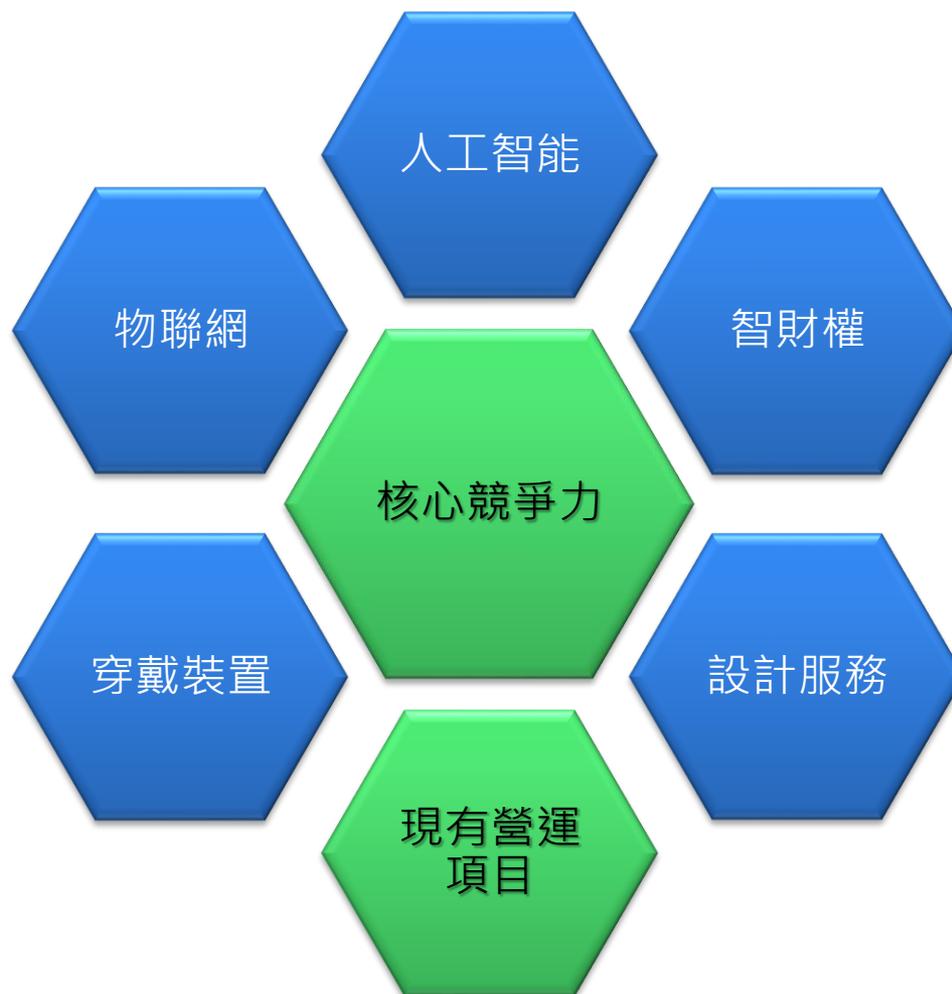


設計服務內容

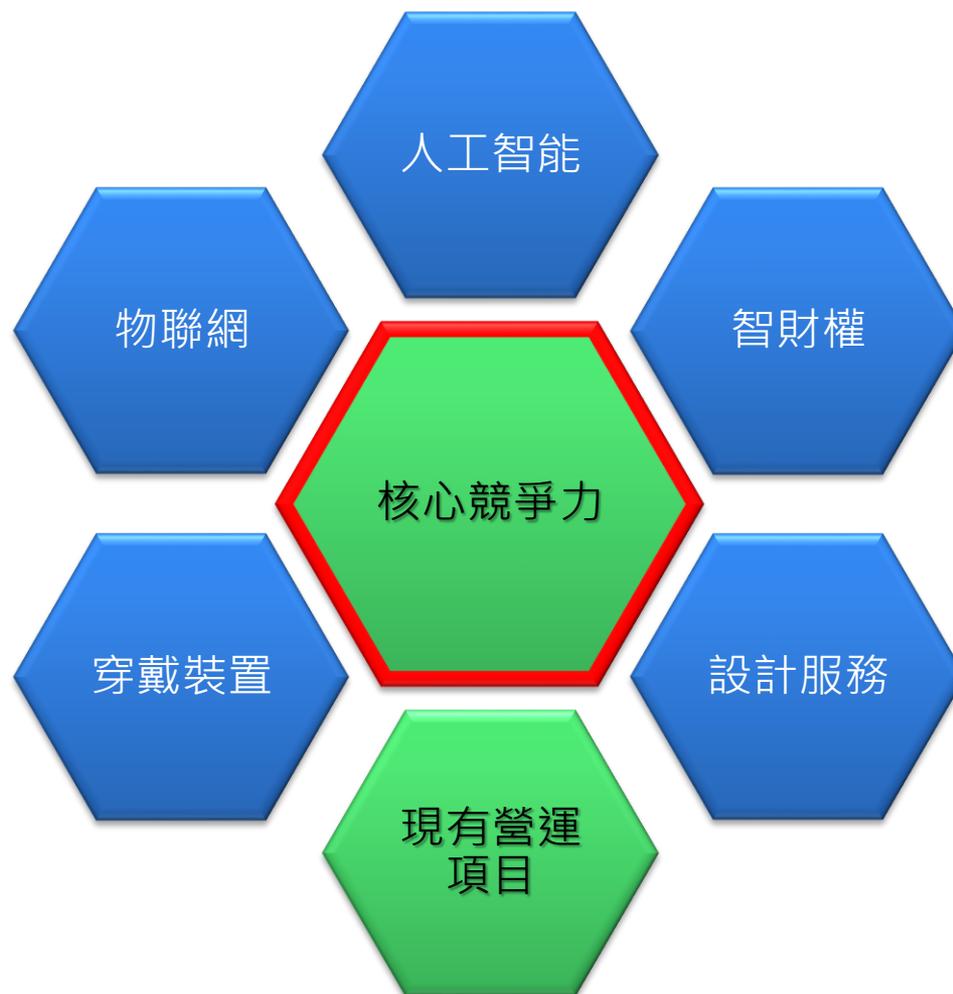
- DRAM – 與DRAM晶圓代工廠提供技術服務，穩定收入
- Logic + DRAM – 人工智能SOC Turnkey
 - 前期設計服務收入，後期產品銷售收入
 - DRAM代工平臺的唯一設計服務夥伴
- 3D DRAM – 記算一體
 - 商業模式：IP 授權 + 3D DRAM 產品銷售
 - 前期設計服務，後期IP授權 + 產品銷售

未來業務方向展望

成長關鍵：客製化+智財權



成長重點：核心競爭力



核心競爭力

- 強大的研發團隊
 - 涵括高性能運算(HPC)及記憶體之開發設計能力
- 邏輯及記憶體之異構集成創新思維
 - 下一代人工智能性能優化之關鍵
- 客製化記憶體的戰略性地位
 - 與晶圓代工廠的策略聯盟

現有業務：強化管理，注重盈利



穿戴裝置：已有成效，待進一步擴大

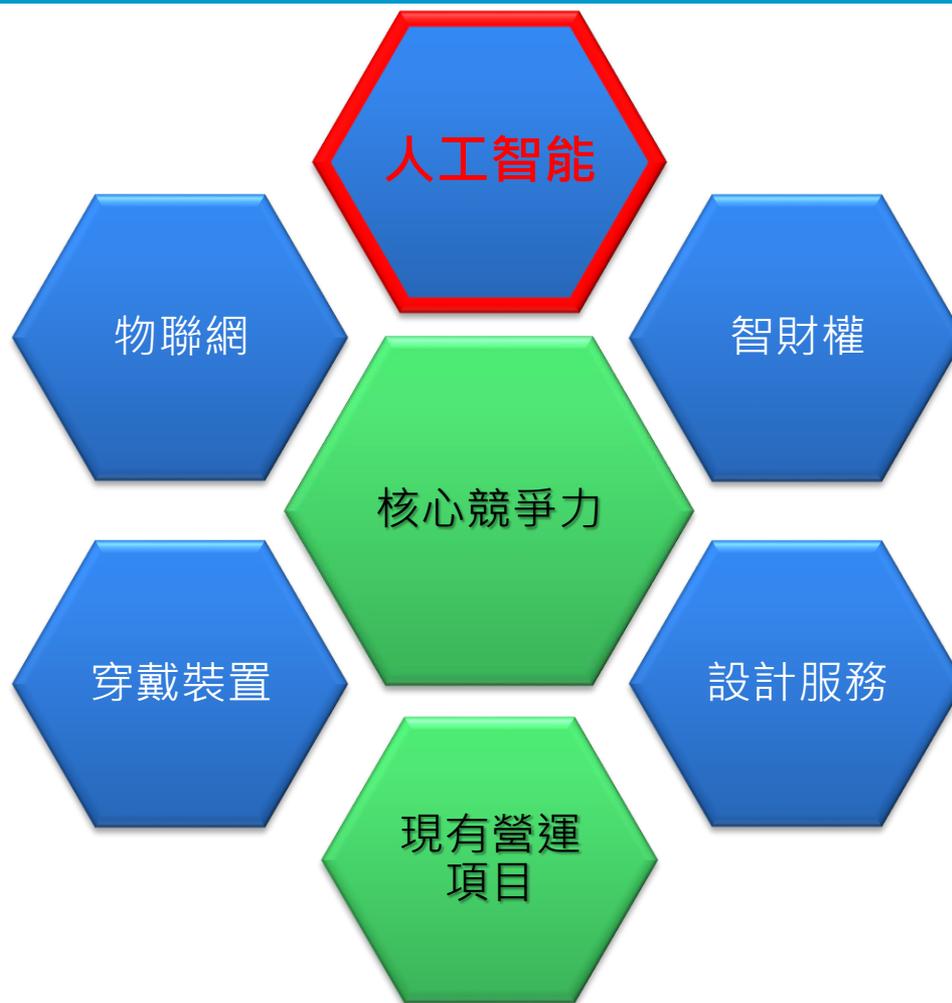
利用低功耗優勢，
強攻MCU平臺
已切入諸多品牌大廠，
包括歐、美、中國大陸一線品牌。
市場仍在成長初期，
預計明後年有明顯營收貢獻



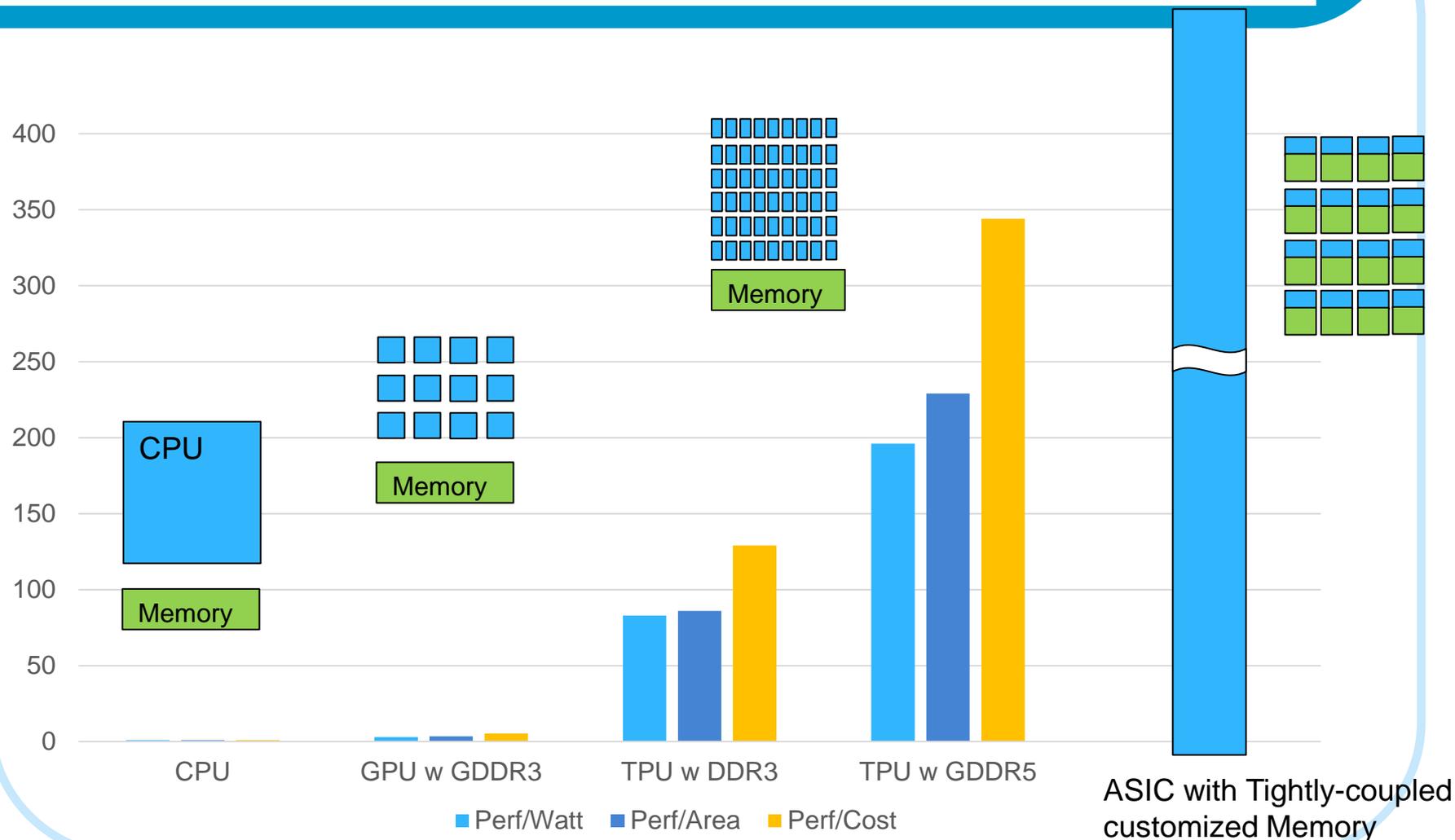
物聯網：已完成佈局，可期龐大市場



人工智能：新藍海



記憶體是目前人工智能發展的瓶頸



Source: Google, Bernstein Research, AP Memory Research

人工智能：新藍海



IP授權，設計服務：盈利的新動能

2018年起
有顯著穩步增長，聯網
可望帶動公司整體盈利。
從DRAM設計
跨入AI Memory SOC設計
以戰略合作方式穿戴裝置**打入AI產業鏈**



結論

- 營運目標
 - 標準產品線：繼續優化，轉型，盈利最大化
 - 客製化產品線：緊跟市場，發揮優勢，擴大營收
 - IP及技術服務：主攻新技術，新方向，帶動盈利
- 管理目標
 - 強化內部管理
 - 落實執行效率



Q & A

發言人信箱：ir@apmemory.com

發言人專線：(03)5601651

Line：

